

证券代码：300024

证券简称：机器人

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	华泰证券、国泰基金、鹏华基金、博时基金、上海璞远资产管理有限公司、北京华诺投资管理有限公司、青岛晟庄私募基金管理有限公司、沈阳锦绣中和资本管理有限公司、沈阳盛京天使私募基金管理有限公司、辽宁卓林投资管理有限公司、辽宁控股（集团）有限责任公司、辽宁上市公司协会、辽宁省基金业协会
时间	2024年5月31日 9:30~11:30
地点	公司展厅、会议中心 101 室
上市公司接待人员姓名	1、总裁：张进 2、董事会秘书：赵陈晨 3、半导体装备业务高级总监：刘国鹏 4、证券事务代表：孙莺绮
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 5 月 31 日（星期五）组织投资者进行参观调研活动。上述活动内容不涉及应披露的重大信息。公司对主要业务情况进行简要介绍，并与投资者进行问答与交流，主要互动问答内容如下：</p> <p>1、问：公司半导体装备业务涉及哪些产品？下游的客户主要有哪些？</p> <p>答：公司半导体业务产品包括大气机械手、真空机械手等系列产品以及 EFEM、真空传输平台，产品主要应用在刻蚀、薄膜沉积、离子注入等工艺环节，涉及硅片生产、晶圆加工、封装等半导体制</p>

造全产业链，下游客户包括如北方华创、中微半导体、屹唐股份、拓荆科技等半导体工艺设备厂商。

目前公司大气类产品（包括 EFEM、大气机械手）、两轴真空直驱机械手、真空传输平台系列产品已实现批量化订单，半导体装备业务应用规模化效应初步显现。随着研发的不断推进以及成果的转化，为此业务板块的快速成长提供了保障。

公司一直以产业安全、实现自主可控为目标，随着半导体行业国产化进程的加快，半导体行业外部环境导致国产替代机会的持续，公司也将为业务释放提前布局产能。

2、问：展望一下国内机器人行业发展趋势？公司如何理解人形机器人在市场中的应用？对于人形机器人有何布局或规划？

答：公司从成立至今形成从零部件、本体到应用的机器人全产业链，与国际先进的机器人企业相比，国内机器人企业发展时间短，应用积累的数据信息库相对小，目前机器人产业处于快速腾飞阶段，是国内机器人企业实现快速发展的最佳时机，机器人不再是解决某项生产加工作业的机械设备，机器人正融合人工智能、大数据等新兴技术向智能化方向发展。未来，随着技术的进一步革新，机器人技术将会迎来更加广阔的发展空间。目前，机器人行业正在经历着快速的发展，其发展趋势主要体现在以下几个方面：

1) 人工智能技术的应用

机器人正在走向智能化，而智能化离不开人工智能技术的应用。通过不断地学习、识别和分析，机器人可以实现人机交互、自主决策、智慧控制等功能。未来，随着人工智能技术的不断成熟和发展，机器人将会变得更加智能化。

2) 机器人将会逐步被应用于更多新的领域

随着机器人技术的不断成熟和发展，机器人将会被应用于更多新的领域，例如：半导体、新能源、智慧医疗、智慧教育、金融、国防等千行百业。

3) 机器人的外形将会更加人性化

随着机器人和人类的接触越来越频繁，机器人将会逐步向更加人性化的方向发展，以更好地与人类进行交流和互动。

目前，公司也在积极布局“机器人+AI”前沿领域，培育、孵化人工智能方向的新业务，公司将充分运用内外资源，与人工智能领域内的优秀企业开展深度合作，加大研究力度，厚积薄发，全力推动公司在 AI 前沿领域的技术创新，探索“人形态机器人”能够结合公司实际业务发展的应用场景，逐步实现机器人与 AI 智能等新技术的融合。

3、问：公司对半导体板块业务资本运作的规划？公司半导体子公司近期引入战略投资者，对公司有什么影响？

答：半导体装备业务是公司主要业务板块之一，目前由沈阳新松半导体设备有限公司、北京新松半导体有限公司及上海新松朴智半导体设备有限公司以独立子公司的形式运营，围绕服务下游客户进行布局。公司将充分运用资本运作能力助力孵化半导体板块业务，并根据自身实际发展需要及下游市场情况，持续促进此业务板块的进一步发展壮大。

公司本次为半导体子公司引入综合实力雄厚的战略投资者，一方面促成与战略客户从业务到资本的深度合作，形成产业链协同效应，加速公司半导体系列产品全面实施国产替代的进程，促进业务规模的迅速扩张；另一方面，本次增资补充了子公司持续扩张的运营资金，加速其产能建设和市场开拓步伐，同时也为子公司持续技术创新提供资金保障，进一步增强其竞争力，扩大品牌影响力。

4、问：半导体行业发展趋势如何？目前国内半导体装备业务领域主要有哪些外资厂商？

答：2023 年，尽管全球半导体设备市场短期受到行业周期性影响，但中国半导体设备市场预计仍会保持增长态势。2023 年中国半导体设备市场规模约为 340 亿美元，同比实现了 8%左右的增长。随着国产化进程的加速推进，以及下游芯片制造等细分领域需求的增长，中国半导体设备行业预计将进一步扩大市场份额，同时带动

	<p>对上游的需求。</p> <p>目前半导体领域内相关产品的外资厂商主要有美国 Brooks、日本 Rorze 等。公司是国内最早能实现半导体机械手产品产业化的企业，真空机械手等产品也是对标国外产品，初始立项旨在解决该领域的国产化需求问题。公司未来会逐步攻克技术难关，进一步提升国有自主可控程度。</p> <p>5、问：对于机器人板块业务出海方面的规划和考虑？</p> <p>答：为破除国内行业“内卷”加剧的困局，公司近年攻坚海外市场，在新加坡、泰国、马来西亚、印度、德国、墨西哥等世界多国构建营销、服务网络，利用与优质客户合作的先发优势，与客户携手共同实现全球性业务拓展。</p> <p>目前，公司海外客户质量及项目执行情况较好，综合海外市场在新能源汽车、锂电领域的扩产需求，未来公司会加大营销布局力度，更紧密的服务于客户海外业务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 3 日